

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成21年6月18日(2009.6.18)

【公表番号】特表2008-537338(P2008-537338A)

【公表日】平成20年9月11日(2008.9.11)

【年通号数】公開・登録公報2008-036

【出願番号】特願2008-506568(P2008-506568)

【国際特許分類】

H 05 K 1/14 (2006.01)

H 05 K 3/36 (2006.01)

H 05 K 1/02 (2006.01)

H 01 R 4/04 (2006.01)

H 01 R 11/01 (2006.01)

【F I】

H 05 K 1/14 J

H 05 K 3/36 A

H 05 K 1/02 L

H 01 R 4/04

H 01 R 11/01 501C

【手続補正書】

【提出日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の第1端から第2端まで伸びる少なくとも1つの導電性配線を表面に有するフレキシブル基板であって、前記少なくとも1つの導電性配線が、前記基板の前記第1端に接続される第1回路と前記基板の前記第2端に接続される第2回路との間の電気的接続を形成するように構成されている、フレキシブル基板と、

導電性粒子を含み、前記基板の前記第1端及び第2端上にある熱硬化性接着剤とを含んでなる、物品。

【請求項2】

前記熱硬化性接着剤によって前記フレキシブル基板の前記第1端に取り付けた第1回路、及び必要に応じて前記熱硬化性接着剤によって前記フレキシブル基板の前記第2端に取り付けた第2回路を更に含む、請求項1に記載の物品。

【請求項3】

前記熱硬化性接着剤が、室温で結晶相を有する、請求項1に記載の物品。

【請求項4】

少なくとも1つの導電性配線を表面に有する第1フレキシブル基板を提供すること、前記少なくとも1つの配線の一部に、導電性粒子を含む熱硬化性接着剤組成物を配置すること、

少なくとも1つの配線を有する第2基板を提供すること、

前記第1基板及び第2基板上の対応する配線を位置合わせすること、及び

前記第1基板及び第2基板を加熱及び加圧下にて接着して、前記対応する配線を電気的に接触させ、且つ前記導電性配線の融点よりも低い温度で、前記配線周囲の前記接着剤を

流動及び硬化させること、を含む方法。

【請求項 5】

前記接着剤が、異方性導電フィルムである、請求項 1 に記載の物品又は請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

前記熱硬化性接着剤組成物が、必要に応じてメラミン／イソシアヌル酸付加化合物を含むタック減少剤を更に含む、請求項 1 に記載の物品又は請求項 4 に記載の方法。

【請求項 7】

請求項 1 に記載の物品を含む、電子物品。